

La tangente de pérdidas de un dieléctrico para aplicaciones de RF suele estar comprendida entre...

- ☐ A. Entre 2 y 10 aproximadamente
- ☒ B. Entre 0.001 y 0.0001 aproximadamente.
- ☐ C. Ninguna de las otras respuestas es correcta.

En la huella (footprint) de un componente de montaje superficial...

- ☒ A. Los pads debe ser siempre de un tamaño ligeramente superior a los pines del componente
- ☐ B. Los pads deben ser siempre de un tamaño ligeramente inferior a los pines del componente
- ☐ C. Los pads deben ser siempre del mismo tamaño que los pines del componente

En una PCB, el "core" está normalmente formado por...

- ☐ A. Un sustrato dieléctrico de espesor 17.5, 35 o 70 micrómetros.
- ☒ B. Un pre-preg y dos láminas de Cu.
- ☐ C. Un sustrato dieléctrico y dos láminas de Cu.

El "wetting" de la soldadura en un pad...

- ☐ A. Depende de la humedad relativa del ambiente.
- ☐ B. Es mejor cuanto mayor es la cobertura del estaño sobre el pad.
- ☐ C. Es mejor cuanto mayor es el ángulo de contacto.

La máscara de soldadura de una PCB tiene entre sus objetivos...

- ☒ A. Ninguna de las otras respuestas es correcta.
- ☐ B. Cubrir los pads para facilitar el proceso de ensamblado y soldadura.
- ☐ C. Cubrir las zonas de la PCB por donde circulan las pistas para evitar cortocircuitos entre ellas.